

## 产品特点

高精度胶片处理技术  
高性能，低温漂，大功率  
陶瓷基板，50Ω共面波导  
金丝键合，适用于多芯片集成模块



## 技术要求

| 项目    | 参数              | 单位  |
|-------|-----------------|-----|
| 中心频率  | 9.0             | GHz |
| 工作带宽  | 6.0-12.0        | GHz |
| 中心损耗  | 1.4             | dB  |
| 带内波动  | 1.0             | dB  |
| 驻波比   | 1.7:1           |     |
| 群时延波动 | 0.5             | ns  |
| 带外抑制  | 30@DC-5.0GHz    | dBc |
| 带外抑制  | 25@13.7-21.0GHz | dBc |

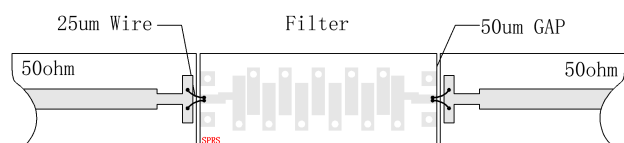
## 其它要求：设计保证

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 承受功率 | 2W CW                        |
| 工作温度 | -55 ~ +85℃                   |
| 储存温度 | -55 ~ +125℃                  |
| 外形尺寸 | L : 6.5 , W : 4.5 , h : 0.39 |

## 外形图：端口居中



## 推荐装配图



| PCB Rogers5880, h:0.254mm | PCB Rogers4350B, h:0.254mm |
|---------------------------|----------------------------|
|                           |                            |

## 注意事项

- 1：芯片建议分腔使用,单侧距侧壁0.1mm,表面距上盖2.61mm,端口可互换;
- 2：芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
- 3：芯片应安装在可伐(推荐) 或铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm /C)相近的材料，载体厚度≥0.2mm;
- 4：微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

## 原理图



## 典型曲线

